

488696-2026 - Zadávání

Irsko – Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) – LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

OJ S 134/2026 15/07/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim - Oznámení oprav
Dodávky

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Education Procurement Service (EPS)

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt

Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: LA3215C-UCC-CFT for the Supply of a Suite of Plasma Etcher and Plasma Deposition Tools, 4 Lots

Popis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Identifikátor řízení: a024c275-b92f-48d9-83b8-52aa370660c8

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

2.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): South-East (IE052)

Země: Irsko

2.1.3. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 3 300 000,00 EUR

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 4

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Zadávací dokumentace

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: Plasma Etcher ,Silicon ,Dielectrics

Popis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interní identifikátor: 1

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): South-East (IE052)

Země: Irsko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 48 Měsíce

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: angličtina

Jazyky, v nichž je zadávací dokumentace (nebo její části) neoficiálně k dispozici: angličtina

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: angličtina

Elektronický katalog: Nepovolena

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Místo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. **Techniky**

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. **Další informace, mediace a přezkum**

Organizace příslušná pro přezkum: The High Court of Ireland

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline: Education

Procurement Service (EPS)

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: The High Court of Ireland

Organizace přijímající žádosti o účast: Education Procurement Service (EPS)

Organizace zpracovávající nabídky: Education Procurement Service (EPS)

5.1. **Část: LOT-0002**

Název: Plasma Etcher ,Metals ,Piezoelectrics

Popis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interní identifikátor: 2

5.1.1. **Účel**

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

5.1.2. **Místo plnění**

Nižší územní jednotka země (NUTS): South-East (IE052)

Země: Irsko

5.1.3. **Odhadovaná doba trvání**

Doba trvání: 48 Měsíce

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: angličtina

Jazyky, v nichž je zadávací dokumentace (nebo její části) neoficiálně k dispozici: angličtina

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: angličtina

Elektronický katalog: Nepovolena

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Místo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: The High Court of Ireland

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline: Education Procurement Service (EPS)

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: The High Court of Ireland

Organizace přijímající žádosti o účast: Education Procurement Service (EPS)

Organizace zpracovávající nabídky: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Část: LOT-0003

Název: Plasma Etcher ,Slow and Controllable Rate ,Atomic Layer Etch for Silicon , Dielectrics

Popis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interní identifikátor: 3

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): South-East (IE052)

Země: Irsko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 48 Měsíce

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: angličtina

Jazyky, v nichž je zadávací dokumentace (nebo její části) neoficiálně k dispozici: angličtina

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: angličtina

Elektronický katalog: Nepovolena

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Místo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: The High Court of Ireland

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline: Education Procurement Service (EPS)

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: The High Court of Ireland

Organizace přijímající žádosti o účast: Education Procurement Service (EPS)

Organizace zpracovávající nabídky: Education Procurement Service (EPS)

5.1. Část: LOT-0004

Název: Plasma Deposition ,PECVD

Popis: Tenders are sought for the supply delivery, installation and commissioning of a suite of tools in 4 Lots for silicon-based and dielectric materials for University College Cork. The new plasma tools will enhance the capabilities at the Tyndall National Institute for the fabrication of semiconductor devices, especially silicon microelectronics and silicon MEMS, but also other materials such as germanium and silicon carbide. We invite proposals for the following lots; Lot 1 Plasma Etcher Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of etching for polysilicon poly-Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 2 Plasma Etcher Metals Piezoelectrics, advanced plasma etching system capable of etching for aluminium Al and alloys molybdenum Mo aluminium scandium nitride AlScN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 3 Plasma Etcher Slow and Controllable Rate Atomic Layer Etch for Silicon Dielectrics, advanced plasma etching system capable of both conventional high-rate etching and slow and controllable rate atomic layer etching for silicon Si silicon dioxide SiO₂ silicon nitride SiN thin films using medium high-density plasma processes. Lot 4 Plasma Deposition PECVD, advanced plasma enhanced chemical vapour deposition system capable of depositing dielectric SiO₂, SiN and amorphous a-Si thin films on semiconductor substrates. This equipment will be essential for etching and depositing a range of materials used in the fabrication of silicon microelectronics, silicon photonics and silicon MEMS devices. The ideal tools will offer precision, reliability, and efficiency to meet the requirements for etching and deposition on both 100 mm and 200 mm diameter wafers. Tenderers with cutting-edge solutions that can achieve these high standards are encouraged to submit their proposals for this vital component in our technological advancement.

Interní identifikátor: 4

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 38000000 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): South-East (IE052)

Země: Irsko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 48 Měsíce

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 3 300 000,00 EUR

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: angličtina

Jazyky, v nichž je zadávací dokumentace (nebo její části) neoficiálně k dispozici: angličtina
Lhůta pro vyžádání dalších informací: 07/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8424094>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/viewTenders.do?resourceId=8424094>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: angličtina

Elektronický katalog: Nepovolena

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Povolena

Lhůta pro doručení nabídek: 24/07/2026 12:00:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 24/07/2026 12:30:00 (UTC+01:00) středoevropský čas, západoevropský letní čas

Místo: <https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8424094>

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: The High Court of Ireland

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline: Education Procurement Service (EPS)

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: The High Court of Ireland

Organizace přijímající žádosti o účast: Education Procurement Service (EPS)

Organizace zpracovávající nabídky: Education Procurement Service (EPS)

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Education Procurement Service (EPS)

Registrační číslo: IE 6609370 G

Poštovní adresa: Castletroy Limerick

Obec: Limerick

PSČ: V94 DK53

Nižší územní jednotka země (NUTS): Mid-West (IE051)

Země: Irsko

E-mail: info@educationprocurementservice.ie

Telefon: 000

Internetová adresa: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Profil kupujícího: <https://www.educationprocurementservice.ie/>

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline

Organizace přijímající žádosti o účast

Organizace zpracovávající nabídky

8.1. ORG-0002

Oficiální název: The High Court of Ireland

Registrační číslo: The High Court of Ireland

Odbor: The High Court of Ireland

Poštovní adresa: Four Courts, Inns Quay, Dublin 7

Obec: Dublin

PSČ: D07 WDX8

Nižší územní jednotka země (NUTS): Dublin (IE061)

Země: Irsko

E-mail: HighCourtCentralOffice@courts.ie

Telefon: +353 1 8886000

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1. ORG-0003

Oficiální název: European Dynamics S.A.

Registrační číslo: 002024901000

Odbor: European Dynamics S.A.

Obec: Athens

PSČ: 15125

Nižší územní jednotka země (NUTS): Βόρειος Τομέας Αθηνών (EL301)

Země: Řecko

E-mail: eproc-esender@eurodyn.com

Telefon: +30 2108094500

Úlohy této organizace:

TED eSender

10. Změna

Znění předchozího oznámení, které má být změněno

:

46fee6a2-f409-4cd6-80db-618a50fcc925-01

Hlavní důvod změny

:

Informace aktualizovány

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 7a2067c1-5ebe-49f4-b53b-0f9595ac5fa3 - 02

Druh formuláře: Zadávací

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 13/07/2026 16:03:29 (UTC+01:00) středoevropský čas,
západoevropský letní čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: angličtina

Číslo zveřejnění oznámení: 488696-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 134/2026

Datum zveřejnění: 15/07/2026